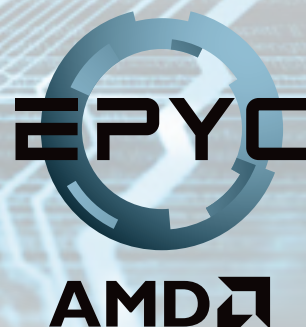
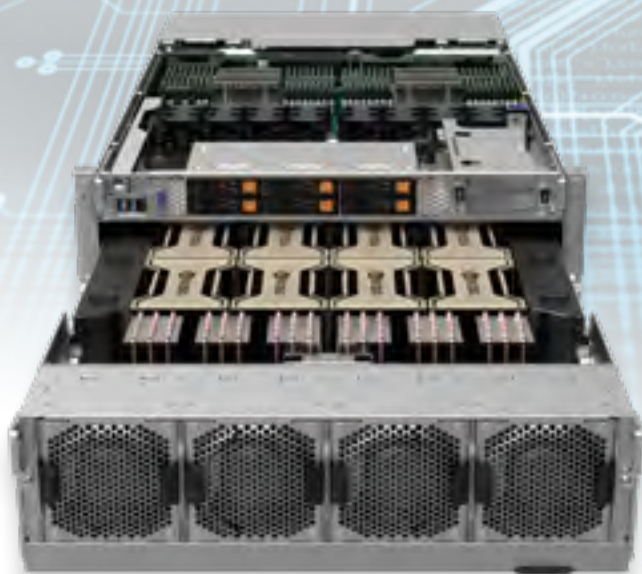


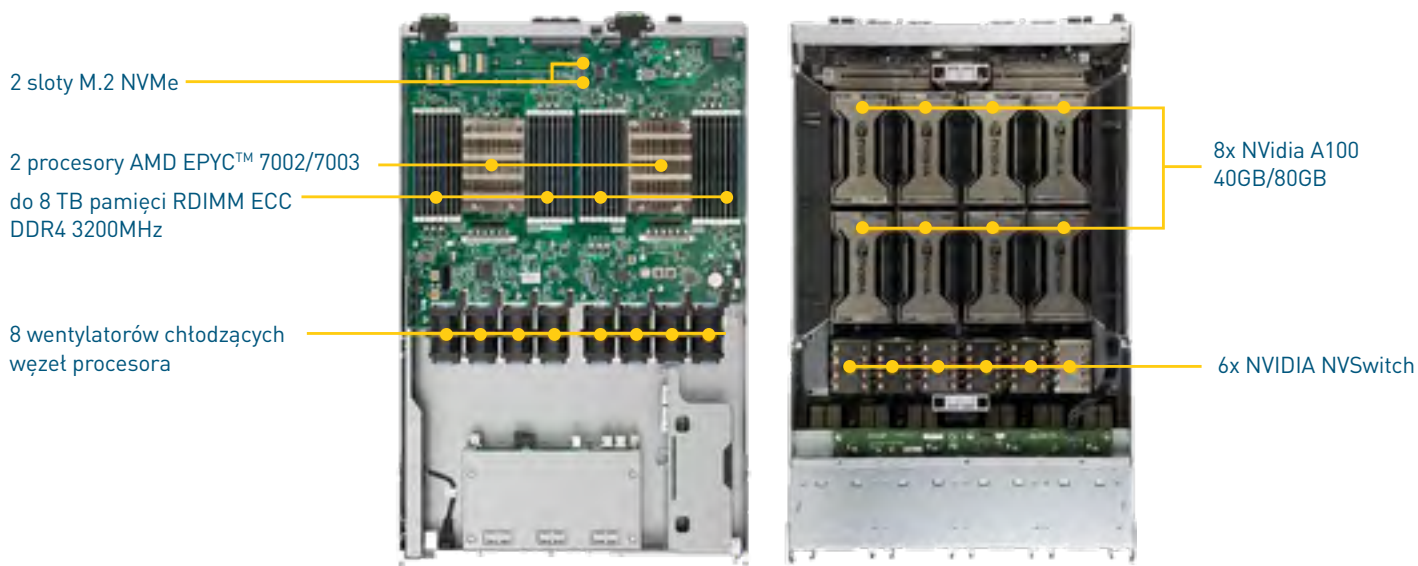
FormatServer THOR ERG21

Dwuprocesorowa platforma serwerowa AMD EPYC™ 7002/7003



Zaprojektowana dla najbardziej wymagających zadań sztucznej inteligencji AI

Platforma serwerowa **FormatServer THOR ERG21** umożliwiającą instalację dwóch procesorów **AMD EPYC™ Rome/Milan**, do 32 modułów DDR4 do 3200MHz do 8TB pamięci RAM oraz 8 akceleratorów NVidia A100 SXM4 połączonych ze sobą technologią Nvidia NVLink oraz Nvidia NVSwitch dostarczające bezkonkurencyjną szybkość komunikacji GPU-do-GPU typu "każdy z każdym" o przepustowości do 600 GB/s.



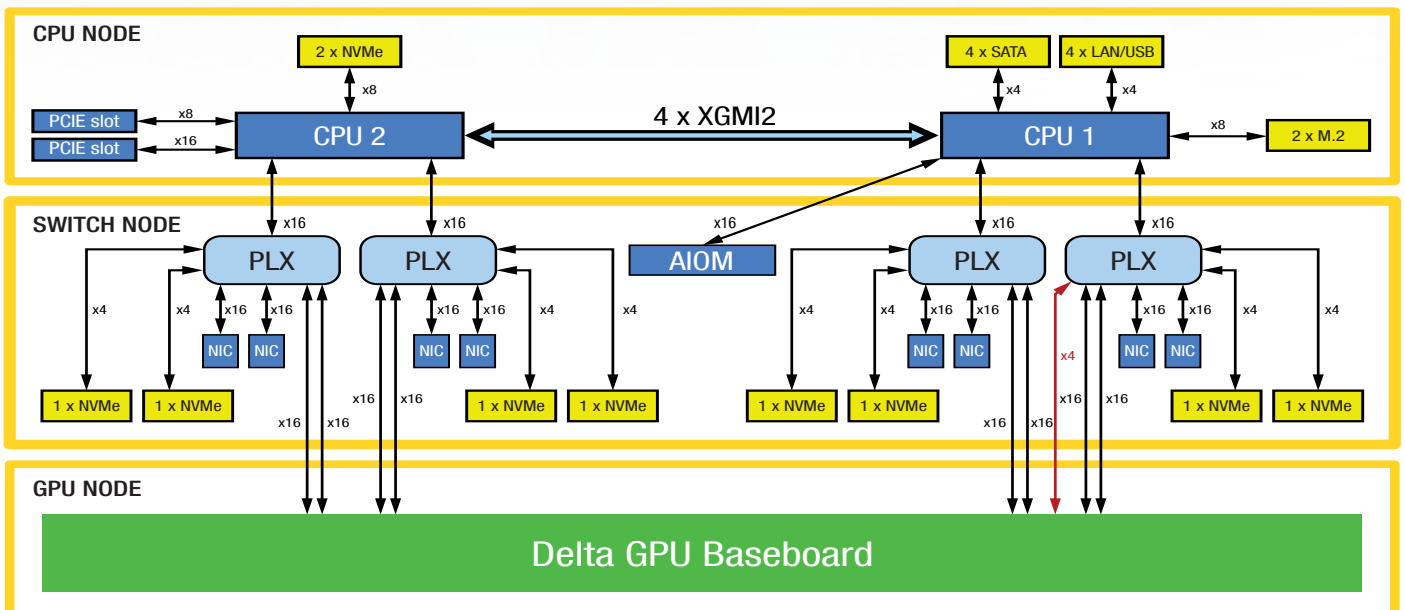


FormatServer THOR ERG21

Model płyty głównej	• Super H12DG0-6
PROCESOR	
CPU	• Dwa procesory AMD EPYC™ serii 7002/7003 (ROME/MILAN) • Socket SP3 • CPU TDP do 280W
Rdzenie	• Do 128 rdzeni (64 / CPU)
Obsługa GPU	• HGX A100 8-GPU 40GB (HBM2) lub 80GB (HBM2e) z NVLink/NVSwitch GPU interconnect i PCI-E Gen4 CPU hosta
PAMIĘĆ OPERACYJNA	
Pamięć	• Liczba slotów pamięci: 32 • Do 8TB 3DS ECC DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM
Typ pamięci	• 3200MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
URZĄDZENIA PŁYTY GŁÓWNEJ	
Chipset	• System on Chip (SoC)
SATA	• SATA3 (6Gbps)
Kontrolery sieciowe	• Poprzez kompatybilne karty rozszerzeń
IPMI	• Wsparcie dla Intelligent Platform Management Interface v.2.0 • IPMI 2.0 z virtual media over LAN oraz KVM-over-LAN
Grafika	• ASPEED AST2600 BMC
WEJŚCIE / WYJŚCIE	
SATA	• 4 porty SATA3 (6Gbps)
LAN	• 1 dedykowany port RJ45 IPMI LAN
USB	• 2 USB 3.0 ports (front)
Video	• 1 złącze VGA (front)
COM Port	• 1 port COM (header) moliwość przekierowania konsoli systemowej
BIOS SYSTEMU	
BIOS Type	• AMI 256Mb SPI Flash ROM

OBUDOWA	
Form Factor	• 4U Rackmount
Model	• CSE-438G
WYMIARY	
Wysokość	• 174 mm
Szerokość	• 446 mm
Głębokość	• 900 mm
Opakowanie	• 750mm x 695mm x 1140mm
Waga	• netto: 75,3 kg, brutto: 102,1 kg
ZATOKI NA DYSKI / STORAGE	
Hot-swap	• 6 zatok, z możliwością opcjonalnej instalacji do 10 zatok NVMe PCIe Gen4 (8 poprzez PCIe switch z obsługą GPU Direct Storage, 2 bezpośrednio do CPU, SATA/NVMe Hybrid lub SAS z opcjonalnym HBA)
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	
PCI-Express	• 8x PCIe 4.0 x16 LP (przez PCI-E switch) z obsługą RDMA (GPUDirect) • 1x PCIe 4.0 x16 LP (Front; przez CPU) • 1x PCIe 4.0 x8 LP (Front; przez CPU)
CHŁODZENIE SYSTEMU	
Wentylatory	• 4x wentylatory dużej mocy Hot-swap 11.5K RPM (GPU) • 6x wentylatorów counter-rotating (CPU) • redundancja wentylatorów N+1
ZASILANIE	
PSU	• 4x zasilacze Hot-swap mocy 3000W w układzie 2+2 Titanium Level (Support smart power)
Typ wyjścia	• Gold Finger (connector on M/P)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
RoHS	• Spełniające RoHS
Specyfikacja środowiskowa	• Temperatura pracy: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) • Temperatura magazynowania: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) • Relatywna wilgotność operacyjna: 8% to 90% (bez kondensacji) • Relatywna wilgotność magazynowania: 5% to 95% (bez kondensacji)

Schemat blokowy systemu



Podane tu informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Firma Format Sp. z o.o. może w każdej chwili i bez powiadomienia dokonać zmian w cyklu życia produktu, specyfikacjach i opisach produktów. Informacje są dostarczane „jako takie” i firma Format Sp. z o.o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w zakresie dokładności danych czy funkcji produktu, dostępności, funkcjonalności czy zgodności wymienionych produktów. Więcej informacji na temat powyższych produktów lub systemów można uzyskać u ich dostawcy. Przedstawiona konfiguracja produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.